Численное моделирование наносекундного переключения *p*-SOS-диода

© Н.И. Подольская, А.Г. Люблинский, И.В. Грехов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021 Санкт-Петербург, Россия e-mail: natalya@scc.ioffe.ru

(Поступило в Редакцию 26 апреля 2017 г.)

01

Проведено численное моделирование процесса резкого обрыва обратного тока большой плотности при переключении с прямого смещения на обратное в кремниевой $p^+P_0n^+$ -структуре (*p*-SOS-диоде). Показано, что в такой структуре обрыв тока происходит вследствие формирования двух динамических доменов сильного электрического поля в областях, где концентрация свободных носителей значительно превышает концентрацию легирующей примеси. Первый домен формируется в n^+ -области у n^+P_0 -перехода, а второй в P_0 -области у границы с p^+ -слоем. Второй домен расширяется существенно быстрее и именно он в основном определяет скорость обрыва тока. Достигнуто хорошее согласие расчета с экспериментом при полном учете реальной электрической цепи, определяющей процессы накачки и выкачки электронно-дырочной плазмы.

DOI: 10.21883/JTF.2017.12.45199.2313

Как было показано в [1], в кремниевом диоде со сверхглубоким, около 150-220 µm, залеганием pn-перехода существует возможность быстрого размыкания тока плотностью в десятки kA/cm² при переключении с прямого смещения на обратное. При прямом смещении короткий импульс прямого тока заполняет электронно-дырочной плазмой базовые слои диодной $p^+p'N_0n^+$ -структуры (режим "накачки"), а при обратном смещении быстро нарастающий импульс обратного тока выносит электроны и дырки из базовых слоев (режим "выкачки" плазмы). Если на каком-нибудь участке базового слоя концентрация выносимых свободных носителей превышает уровень легирования, то там формируется область объемного заряда (ООЗ) — домен сильного поля, сопротивление диодной структуры возрастает и ток из нее переходит в нагрузку, подключенную параллельно. Этот эффект был назван SOS-эффектом (SOS — Semiconductor Opening Switch). Численное моделирование SOS-эффекта в $p^+p'Nn^+$ -структуре на основе кремния n-типа проводимости со сверхглубоким *р'N*-переходом (SOS-диод) было проведено, например, в [2-4] и др.

В [5] была предложена и исследована экспериментально более простая и эффективная структура SOS-диода, а именно $p^+P_0n^+$ -структура на основе кремния *p*-типа проводимости (*p*-SOS-диод). В настоящей работе приводятся первые результаты численного моделирования физических процессов в *p*-SOS-диоде. Конструкция *p*-SOS-диода показана на рис. 1. Она выполнена на кремнии *p*-типа проводимости с $\rho = 40 \Omega \cdot \text{сm}$, глубины залегания p^+P_0 -перехода и P_0n^+ -перехода составляли около $70 \,\mu$ m, а ширина P_0 -области составляла около $60-80 \,\mu$ m. Общая толщина структуры составила примерно $210 \,\mu$ m. Таким образом, *p*-слой состоит из двух частей — высоколегированной *p*⁺-части, полученной диффузией бора с поверхностной концентрацией

 $1 \cdot 10^{20} \, \mathrm{cm}^{-3}$, и слаболегированной P_0 -части, уровень легирования которой определялся исходным кремнием. Переход n^+P_0 был получен диффузией фосфора с поверхностной концентрацией 8.5 · 10¹⁹ ст⁻³. Время жизни неосновных носителей в Ро-слое составляло $\sim 10\,\mu$ s. Эквивалентная схема генератора импульсов, использованная при численном моделировании работы p-SOS-диода и включающая в себя контуры накачки и выкачки, показана на рис. 2. Накачка плазмы осуществлялась импульсом прямого тока с длительностью ~ 40 ns и амплитудой плотности тока $\sim 1.7 \, \text{kA/cm}^2$, а выкачка — быстронарастающим импульсом обратного тока длительностью ~ 12 ns. В этом режиме при плотности тока выкачки в момент обрыва $\sim 5.3 \, \mathrm{kA/cm^2}$ время обрыва тока составляло ~ 2.5 ns, а максимальное напряжение на нагрузке ~ 450 V.



Рис. 1. Профиль легирования *p*-SOS-диода. Вертикальные линии обозначают границы слоев p^+ , P_0 и n^+ . Штрихпунктирная линия соответствует концентрации электронов, а штриховая — дырок.



Рис. 2. Эквивалентная схема генератора импульсов с учетом паразитных параметров, использовавшаяся в численном моделировании работы *p*-SOS-диода.

Динамика электронов и дырок в *p*-SOS-структуре моделировалась в одномерном приближении в рамках диффузионно-дрейфовой модели путем совместного решения уравнения Пуассона, уравнений непрерывности и уравнения Кирхгофа для внешней цепи с помощью специализированного программного обеспечения Silvaco [6]. Численное моделирование процессов переключения проводилось в эквивалентной схеме генератора импульсов с учетом паразитных параметров (паразитная индуктивность выводов использующихся MOSFET транзисторов L₄ и эквивалентное последовательное сопротивление конденсаторов R_3 , R_4 и R_5), величины которых были тщательно измерены (приведены на рис. 2). Резистор R₂ соответствует шунту, используемому в эксперименте для регистрации тока, проходящего через *p*-SOS-диод. Учет паразитных параметров в эквивалентной схеме при численном моделировании работы диода оказался необходимым для получения хорошего количественного согласия результатов численного моделирования и эксперимента. Отметим, что наблюдалась сильная чувствительность к малым изменениям не только значений параметров электрической схемы, но и толщин слоев диодной структуры, которые для исследованной в [5] структуре *p*-SOS-диода не измерялись непосредственно. Представленные на рис. 3-5 результаты получены для структуры с толщинами p^+ , P_0 и n^+ -слоев 70, 60 и 80 μ m соответственно.

На рис. 3 показаны осциллограммы плотности тока 1 и напряжения 2 на этапе нарастания и обрыва обратного тока в *p*-SOS-диоде, полученные экспериментально [5]. Также на рис. 3 приведены расчетные кривые плотности тока 3 и напряжения 4, полученные в схеме генератора импульсов (рис. 2) с *p*-SOS-диодом. В рамках проведенного одномерного численного моделирования получено приемлемое согласование расчетных и экспериментальных зависимостей плотности тока на диоде от времени и очень хорошее согласование зависимости напряжения на нагрузке от времени. Черными точками

на расчетных кривых плотности тока и напряжения отмечены моменты времени, для которых на рис. 4, 5 показаны распределения концентрации электронов и дырок, а также напряженности электрического поля в *p*-SOS-диоде.

На рис. 4 представлено распределение электронно-дырочной плазмы с высокой плотностью в момент окончания импульса тока накачки и начала импульса выкачки, а именно в момент времени 48 ns. На рис. 5 продемонстрирована динамика изменения профилей концентраций



Рис. 3. Осциллограммы, полученные в рамках эксперимента (штрихпунктирные линии) и численного моделированиия (сплошные линии). Кривые *1* и *3* соответствуют зависимостям плотности тока в *p*-SOS-диоде от времени, кривые *2* и *4* напряжения на нагрузке от времени, черные точки обозначают времена, для которых далее приводятся распределения электрического поля и концентраций носителей внутри модельной структуры.



Рис. 4. Распределение электрического поля и концентраций носителей в структуре диода в момент начала процесса выкачки (48 ns). Сплошная черная линия (1) соответствует распределению электрического поля, штриховая линия (2) — распределению концентрации дырок, а штрихпунктирная линия (3) — электронов. Вертикальные линии обозначают границы слоев p^+ , P_0 и n^+ .



Рис. 5. Распределение электрического поля и концентраций носителей в структуре диода в моменты времени процесса выкачки 60, 60.5, 61.5, 62.3, 63, 65.9 пs. Сплошная черная линия соответствует распределению электрического поля, штриховая линия — распределению концентрации дырок, а штрихпунктирная линия — электронов. Вертикальные линии обозначают границы слоев p^+ , P_0 и n^+ .

электронов и дырок, а также электрического поля на стадии выкачки в наиболее характерные последовательные моменты времени: 60, 60.5, 61.5, 62.3, 63 и 65.9 пs. Видно, что на момент начала процесса выкачки, т. е. в момент времени 48 пs, в диоде наблюдается довольно слабое электрическое поле. Однако в момент времени 60 пs справа от границы n^+P_0 -перехода в n^+ -области с относительно невысокой концентрацией легирующей примеси начинается формирование ООЗ на свободных электронах, т. е. SOS-эффект. Максимальное электрическое поле в ООЗ ограничено ударной ионизацией и потому не превышает 200 kV/ст. В p^+ -области аналогичный эффект формирования ООЗ на свободных дырках выражен значительно слабее, однако по мере нарастания плотности тока выкачки (рис. 5 для моментов времени t = 61.5и 62.3 ns) этот эффект становится определяющим и в основном приводит к резкому спаду тока и росту напряжения на приборе. Следует отметить, что n^+P_0 -переход начинает "блокировать" напряжение в момент времени t = 65.9 ns при довольно малой плотности тока. Этот процесс сопровождается небольшим всплеском напряжения и соответственно уменьшением тока, хорошо заметным на рис. 3 в момент времни примерно 66 ns. Поскольку амплитуда и длительность протекания импульса тока через запертый n^+P_0 -переход относительно невелики, этот процесс не приводит к разрушению прибора.

Таким образом, численное моделирование процесса резкого обрыва тока в кремниевой $p^+P_0n^+$ -структуре p-SOS-диода показывает, что обрыв нарастающего импульса обратного тока происходит вследствие формирования динамического домена сильного поля в областях, где концентрация свободных носителей превышает концентрацию легирующих примесей. Сначала один домен формируется в n^+ -области у n^+P_0 -перехода, где концентрация свободных электронов, выносимых из плазмы, превышает концентрацию доноров, а затем в *Р*₀-области у границы с *р*⁺-слоем формируется второй домен на свободных дырках. Этот домен расширяется существенно быстрее и именно он в основном определяет скорость обрыва тока. На завершающей стадии процесса при сравнительно малой плотности тока происходит восстановление *n*⁺*P*-перехода и полный обрыв остаточного тока.

Авторы признательны П.Б. Родину за полезные обсуждения.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-29-00094).

Список литературы

- [1] Котов Ю.А., Месяц Г.А., Рукин С.Н., Филатов А.А. // ДАН. 1993. Т. 330. Вып. 3. С. 315–317.
- [2] Рукин С.Н., Цыранов С.Н. // ФТП. 2009. Т. 43. Вып. 7. С. 989–995.
- [3] Любутин С.К., Рукин С.Н., Словиковский Б.Г., Цыранов С.Н. // ФТП. 2012. Т. 46. Вып. 4. С. 535–543.
- [4] Engelko A., Bluhm H. // J. Appl. Phys. 2004. Vol. 95. I. 10. P. 5828–5836.
- [5] Грехов И.В., Люблинский А.Г., Белякова Е.И. // ЖТФ. 2016.
 Т. 86. Вып. 3. С. 106–109.
- [6] SILVACO ATLAS, User guide, http://www.silvaco.com